

**中信证券股份有限公司**  
**关于上海艾为电子技术股份有限公司**  
**2023 年度持续督导跟踪报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅《上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《上海艾为电子技术股份有限公司内部控制审计报告》等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### (一) 业绩增速下滑或亏损的风险

全球经济出现了经济增速下行和欧美的大通胀，受整体宏观经济及国际地缘政治冲突、半导体周期下行等因素影响，国内外市场需求均呈现不同程度的萎缩，终端市场需求疲软，或将导致公司营业增长不及预期，而同时近年来公司持续处于研发高投入发展阶段，可能导致盈利情况出现波动甚至下滑。目前全球宏观经济尚未回暖，为满足公司未来业务拓展的需要，公司持续加大研发投入，且人力成本上涨存在刚性特征，如营业收入增长不及预期，则业绩存在下滑的风险。

### (二) 核心竞争力风险

#### 1、技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业为典型的技术密集型行业，技术的升级与产品的迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。如果公司在后续研发过程中对市场需求判断失误或研发进度缓慢，将面临被竞争对手

抢占市场份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金投入大、研发风险高的特点，在研发过程中很可能存在因某些关键技术未能突破或者产品性能、参数、良率等无法满足市场需要而研发失败、落后于新一代技术的风险。

由于公司下游终端客户多为知名品牌客户，其产品系列齐全，对公司产品型号有相对长期的使用需求，因此，公司大部分主要型号产品在上市后拥有 5 年以上的生命周期。如果公司不能根据行业及客户需求保持较快的技术迭代和技术迭代，不能保持持续的创新能力及贴紧下游应用的发展方向，并持续推出具有竞争力的新产品，将导致公司市场竞争力下降，并给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

### **（三）经营风险**

#### **1、公司产品为通用型芯片，下游应用集中于新智能硬件的消费电子领域，受下游消费电子出货量影响较大的风险**

报告期内，在消费电子领域的收入较为集中，全球新智能硬件消费市场的景气程度和出货量会影响品牌客户对公司芯片的使用需求。若未来新智能硬件消费市场需求萎缩造成出货量下降，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

#### **2、市场竞争风险**

集成电路行业受国家政策鼓励且发展迅速，行业内企业逐渐增多。一方面，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展；另一方面，新进入厂商也不断抢夺市场份额，市场竞争逐渐加剧。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

此外，相较于公司 1,200 余种芯片产品型号，同行业集成电路国际巨头，如 TI 和 ADI，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了下游大部分应用领域。一旦国际巨头企业采取强势的市场竞争策略与公司同类产品进行竞争，将会对公司造成较大的竞争压力，如公司不能实施有效的应对措施，及时弥补竞争劣势，将对公司的竞争地位、市场份额和经营业绩造成不利影响。

### **（四）财务风险**

## 1、毛利率波动风险

近年来，集成电路设计行业受到社会、市场和资本的关注度不断提高，竞争逐步加剧。国际方面，公司与同行业龙头企业相比，公司某些产品在产品布局的丰富程度、工艺制程与性能表现等技术指标的先进程度、经营规模或市场占有率的领先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产品线所面对的竞争对手也在逐渐增多。2022年下半年以来，由于消费类电子下行，部分产品供求关系已经发生变化，给行业整体的毛利率水平带来明显冲击，2023年毛利率为24.85%，低于2022年度的38.08%。未来，如技术水平进步、人工和原材料价格上涨以及公司产品议价能力下降，且公司不能采取有效措施以巩固和增强产品竞争力，公司主要产品销售均价和综合毛利率也将面临持续下降的风险，进而造成公司在激烈的市场竞争中处于不利地位，降低持续盈利能力。

## 2、存货规模较大及跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品构成。本报告期末，公司存货账面价值为67,474.91万元，较2022年存货下降23.27%，存货价值降幅较大；公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，2023年年末公司存货跌价准备余额11,257.88万元；若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

## 3、汇率波动风险

因公司的海外业务通常以美元进行计价并结算，香港艾唯记账本位币为美元，同时公司存在较多的境内外母子公司关联交易，汇率波动将会对公司汇兑损益及其他综合收益——外币报表折算差造成影响。报告期内，公司汇兑收益金额为150.65万元，主要系外币交易过程中产生的已实现汇兑损益和期末持有的外币资产负债因汇率变动产生的未实现汇兑损益；报告期末，公司其他综合收益——外币报表折算差额为3,310.10万元，主要系香港艾唯的外币报表折算差及母子公司之间关联交易产生的汇率折算差。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。

## （五）行业风险

公司是集成电路设计企业，主要从事集成电路芯片产品的设计、研发及销售，属于集成电路行业的上游环节。全球集成电路行业在近些年来一直保持稳步增长的趋势，但由于该行业是资本及技术密集型行业，随着技术的更迭，行业本身呈现周期性波动的特点，并且行业周期的波动与经济周期关系紧密。如果宏观经济发生剧烈波动或存在下行趋势，将导致行业发生波动或需求减少，使包括公司在内的集成电路企业面临一定的行业波动风险，对经营情况造成一定的不利影响。

## （六）宏观环境风险

### 1、国际贸易摩擦风险

国际贸易环境对公司经营影响较大的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，屡屡采取长臂管辖措施，对我国集成电路产业有所冲击。集成电路行业具有典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对包括本公司在内的集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。

## （七）其他重大风险

### 1、规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司的业务规模进一步扩大。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模快速扩张，那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

### 2、募集资金投资项目实施风险

公司募投项目“智能音频芯片研发和产业化项目”、“5G 射频器件研发和产业化项目”、“马达驱动芯片研发和产业化项目”、“电子工程测试中心建设

项目”、“发展与科技储备资金”及“高性能模拟芯片研发和产业化项目”正在逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，产品营销网络开拓不利，则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或不能达到预期收益的实施风险，对公司业绩产生不利影响。此外，上述募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	253,092.15	208,952.16	21.12
归属于上市公司股东的净利润	5,100.89	-5,338.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,965.10	-10,713.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	42,879.94	-38,698.08	不适用
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	362,205.39	353,529.67	2.45
总资产	493,579.77	472,857.76	4.38
主要财务指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.22	-0.23	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	0.22	-0.23	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.39	-0.46	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.43	-1.46	增加2.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资	-2.51	-2.94	增加0.43个百分点

产收益率（%）			
研发投入占营业收入的比例（%）	20.05	28.54	减少8.49个百分点

2023 年度，公司营业收入同比上升 21.12%，主要系 2023 年下半年随着行业需求逐步复苏及客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。报告期内，尽管公司面临艰难的外部环境，但仍坚持持续地进行研发投入、持续丰富和优化产品品类和结构、不断开拓市场领域和客户群体，同时根据客户需求及时进行技术和产品创新，加快产品迭代。通过多年的积累，公司形成了一系列富有市场竞争力的产品，能够满足不同客户的多样性需求，最终实现营业收入的同比增长。

2023 年度，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益实现扭亏为盈，主要系：本期营业收入较上年增长、本期计提的资产减值损失及股份支付金额较上年减少、本期确认的投资收益增加及享受了集成电路设计企业增值税加计抵减政策所致。

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期由净流出转为净流入，主要系本期营业收入增长收到的货款增加及本期去库存化形成支付的采购货款减少所致。

2023 年度，公司扣除非经常性损益后的每股收益亏损较上年同期减少，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损较上年同期有所改善。

2023 年度，公司研发投入占营业收入比例较上年同期减少 8.49 个百分点，主要系报告期内营业收入的增长及研发费用的下降所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

#### 1、领先的核心技术优势

##### （1）技术积累丰富，具备持续创新能力

公司技术、客户、供应链、人才等多项优势紧密结合、发展迅猛。技术方面，公司积累了大量模拟芯片设计开发经验，截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股

子公司累计获得发明专利 302 项，实用新型专利 225 项，外观设计专利 5 项，软件著作权 111 件，集成电路布图登记 558 个。

### (2) 产品领域延伸性强，响应国产化替代需求

公司秉持现代化的集成电路工艺和设计理念，在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。公司在数模混合信号链领域深耕多年，紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新。公司从高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片产品出发，陆续拓展丰富子类产品线，各类产品技术持续发展，形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力，积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

### (3) 细分市场具备较强的产品和技术优势

公司主要产品包括高性能数模混合信号芯片、电源管理芯片、信号链芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。其中，公司在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势，特别是在 Haptic 触觉反馈和 Camera AF&OIS 领域。在电源管理芯片和信号链芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展。

## 2、人才团队优势

集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 722 人，占全部员工人数的比重达 75%，主要研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验；共有核心技术人员 5 人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

公司重视人才管理体系建设，在人才管理职业发展通道、薪酬激励体系、干部管理体系、招聘管理等系统及建设方面起步早，保持行业领先。公司制定了员工职级职等管理政策、干部管理政策、技术职位任职资格管理体系等一系列人才培养政策。公司持续引入行业顶尖人才，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，



加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。此外，公司优质的人才保障制度和文化氛围，不断增强创新人才吸引力和凝聚度，支撑公司持续创新。

### **3、产品市场优势**

公司产品主要应用于消费电子、AIoT、工业、汽车领域，通过多年的积累，公司拥有丰富且齐全的产品系列，公司产品在技术领域覆盖高性能数模混合芯片、电源管理芯片、信号链芯片，产品型号达到 1,200 余款。公司开发的音频功放芯片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GNSS 低噪声放大器、FM 低噪声放大器、马达驱动等各类产品在消费电子、AIoT、工业、汽车的市场得到广泛认可，并广泛应用于知名品牌厂商的终端产品，公司研发的多款产品在半导体领域获得了诸多奖项。

### **4、客户资源优势**

公司拥有丰富的客户资源，已纳入众多知名品牌客户的合格供应商名录。公司产品以新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括三星、小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想、微软、Samsung、Meta、Amazon、Google 等众多品牌客户。以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；车载领域客户包括阿维塔、比亚迪、零跑、奇瑞、长安、吉利、现代等。公司在可穿戴设备、智能便携设备和物联网、工业、汽车等细分领域，持续拓展了细分领域知名企业。

### **5、业务连续性优势**

公司重视业务连续性，报告期内开始搭建能够保障业务连续性的规则体系，公司采用单一料号多供应商布局，引入国产设备，公司数据多平台备份，多地布局仓储中心等，保证公司能够适应和应对多变及复杂的市场情况。

## **（二）核心竞争力变化情况**

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未

发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	50,737.07	59,628.90	-14.91
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	50,737.07	59,628.90	-14.91
研发投入总额占营业收入比例 (%)	20.05	28.54	减少8.49个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

本年研发投入总额较上年下降 14.91%，主要系公司持续推进管理变革包括产研过程数字化，逐步提高研发效率，同时在本报告期内工程开发费、股份支付费用较同期减少所致。

### （二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	大功率天线切换开关	10,024.00	1,548.41	9,335.35	验证阶段	实现高功率天线切换，高谐波性能，快速切换	国内领先	智能手机等
2	升压数字音频功放	13,592.00	1,160.98	12,889.54	验证阶段	数字音频接口，带升压，振幅和温度保护，超低噪声音频功放驱动芯片	国内领先	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
3	LDO 电源管理集成芯片	574.00	59.45	536.41	结束阶段	实现大电流驱动能力和高性能 LDO 芯片	国内领先	工业、智能安防、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等
4	同步降压变换器	935.00	194.30	828.27	验证阶段	实现高效率、快速负载瞬态	国内领先	智能手机、平板电脑

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						响应能力的大电流同步降压变换器		等
5	低功耗电容式触摸	1,249.00	373.26	1,174.72	结束阶段	实现超低功耗电容检测技术，形成系列化的触摸按键产品	国内领先	可穿戴设备、TWS耳机、智能家居设备等
6	用于可穿戴产品的高性能模拟芯片	14,563.00	3,283.02	13,360.99	验证阶段	实现可穿戴产品相关各类电源管理芯片的开发，如保护开关、切换开关和电平转换等	国内领先	平板电脑、智能音箱、可穿戴设备等
7	模拟音频功放芯片	3,986.00	195.72	3,703.78	结束阶段	实现模拟音频功放芯片系列化和性能升级	国内领先	智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
8	触觉反馈驱动芯片	10,994.00	2,861.70	9,840.44	验证阶段	实现听觉、触觉同步的触觉反馈驱动芯片	国内领先	IoT、工业、智能手机、手表等
9	用于智能手机的WLED驱动器	3,399.00	826.48	3,068.14	结束阶段	实现高精度、低电流背光驱动	国内领先	智能手机、平板电脑、电子书等
10	高压数字智能音频功放	14,781.00	3,593.27	13,293.38	验证阶段	采用数字音频接口，高压，振幅和温度保护的智能音频功放驱动芯片	国内领先	音响、可穿戴、智能手机等智能通信设备
11	用于锂电系统的小尺寸高效率的功率器件	745.00	145.43	565.13	验证阶段	实现不同种类封装，低导通阻抗MOS芯片	国内领先	手机、IoT、汽车、工业
12	5G射频开关	8,237.00	1,200.19	7,429.14	验证阶段	研发5G手机中的通用射频开关，包括TRX、RX等类型	国内领先	智能手机、模组、5G其余应用等
13	高灵敏度低	2,675.00	653.56	2,476.79	验证	实现高灵敏	国内领先	智能家居、

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
	功耗电容式接近传感器芯片				阶段	度、低功耗的电容接近检测	先	可穿戴设备、平板电脑、智能手机等
14	超低功耗触摸按键控制芯片	1,439.00	224.02	1,362.00	结束阶段	实现超低功耗的电容按键检测技术，形成系列化的触摸按键产品	国内领先	可穿戴设备、TWS耳机、智能家居设备等
15	大功率高精度闪光灯	2,106.00	531.20	2,004.69	验证阶段	实现高精度、高电压、大电流闪光灯驱动	国内领先	安防、笔记本电脑等
16	高性能的工业，汽车电源芯片	15,279.00	4,019.95	6,990.91	设计阶段	实现工业、汽车和消费类电源管理芯片的开发，如保护开关、切换开关和电平转换等	国内领先	工业、汽车、平板电脑、可穿戴设备等
17	4G/5G 前端高性能开关和模组	9,681.00	2,042.36	4,731.25	验证阶段	实际天线调节作用的开关；实现 5G 前端单路和多路以及 SRS 等功能的前端模组和单 LNA；实现多天线系统中不同天线之间的切换，多收发通道中不同收发通道的切换	国内领先	智能手机、5G 应用等
18	汽车模拟大功率音频功放芯片	13,824.00	5,370.66	5,949.44	设计阶段	实现模拟大功率音频功放芯片开发和性能升级	国内领先	汽车、工业、音箱、电视等
19	汽车数字音频功放及 ADC 项目	8,500.00	4,157.79	6,516.33	验证阶段	实现汽车数字大功率音频功放芯片和软件算法升级	国内领先	汽车、安防、手机、平板电脑、笔记本电

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
								脑等
20	线性/直流/步进马达驱动芯片	7,472.00	2,899.09	4,224.48	验证阶段	实现马达驱动芯片小尺寸&高压、大功率	国内领先	汽车、工业、手机、穿戴
21	低功耗，高效率的 IOT 开关电源芯片	2,828.00	367.3	780.15	设计阶段	实现高效率、快速瞬态响应能力的同步降压电压转换器	国内领先	智能音箱、安防、路由器等
22	应用于工业的低阻抗高压 MOS	2,385.00	204.55	574.28	结束阶段	实现低阻抗高耐压，高速电源开关	国内领先	汽车逆变器、工业、电动工具、锂电池管理系统、同步整流电路等
23	磁传感器与摄像头驱动芯片	6,632.00	1,805.36	2,402.20	验证阶段	实现 Hall 产品系列化，芯片内部包含温度补偿，保障磁特性稳定	国内领先	笔电、智能家居、智能穿戴
24	内置高压 DCDC 的车载 LED 驱动	3,036.00	1,243.38	1,860.08	设计阶段	实现多路数 GPIO 并兼容多路数 LED 电流沉驱动	国内领先	汽车、智能音箱、键盘、数码管驱动
25	高性能车载 LED 氛围灯驱动	6,244.00	2,171.18	2,644.03	设计阶段	实现高速 LIN RGB 控制、高性能 LED 温度补偿	国内领先	汽车、工业等
26	高性能信号链芯片	5,543.00	1,640.95	2,293.03	设计阶段	实现高可靠性、高性能 CAN FD 收发器；实现高电源和共模输入电压、低失调高精度运算放大器；实现高电源电压、高可靠性比较器	国内领先	汽车、两轮骑行、工厂自动化、电器、电网基础设施、ICT、伺服、变频器、工业控制、安防、光伏、白色家电等

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
27	低噪声放大器系列化	2,117.00	477.24	477.24	设计阶段	实现低功耗、低噪声 GNSS LNA	国内领先	智能手机、IOT 等
28	Type-C 端口产品系列化项目	1,298.00	118.33	118.33	设计阶段	实现高可靠性、高压耐压的 USB 端口保护产品升级	国内领先	工业、AIoT、笔记本电脑、平板电脑等
29	应用于手机市场的 Display power 开发	2,737.00	237.84	237.84	设计阶段	实现高效率/低纹波 AMOLED power PMIC	国内领先	智能手机、平板电脑等中小尺寸带屏的设备
30	射频 RF 开关产品升级项目	1,008.00	310.56	310.56	验证阶段	实现 5G RF 开关产品低插损、耐受功率、S 参数性能提升	国内领先	手机、模块等通讯设备
合计		<b>177,883.00</b>	<b>43,917.53</b>	<b>121,978.92</b>		/	/	/

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集

资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

由于“电子工程测试中心建设项目”的建设周期长、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，同时建设测试生产线，提升公司芯片测试的产能，确保公司在未来半导体发展的局势中占据行业主导地位。公司拟将“研发中心建设项目”结项后的剩余募集资金 18,932.47 万元及其衍生利息、现金管理收益，用于“电子工程测试中心建设项目”。公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项的议案》，同意将“研发中心建设项目”投资总额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，使用募集资金拟投入金额由 40,824.76 万元变更为 21,892.29 万元，为进一步提高募集资金使用效率拟将“研发中心建设项目”调整后的剩余募集资金用于公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”。公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐人就此事项出具了明确的核查意见。2023 年 10 月 28 日对相关事项进行了公告。2023 年 11 月 14 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会会审议并通过了前述议案。

公司募投项目“电子工程测试中心建设项目”原计划达到预订可使用状态日期为 2024 年 8 月，延期后达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月。公司于 2023 年 1 月通过招拍挂手续取得项目用地并签署土地出让合同，并于 2023 年 4 月取得以上募集资金投资项目用地的不动产权证。该项目设计方案于 2023 年 10 月通过审批，2023 年 11 月份达到可以进场施工的状态。目前该项目处于基坑围护阶段。该项目立项后，因外部环境原因，无法与临港规资处有效沟通导致拿地方案的审批推迟，亦无法与政府部门各委办单位有效沟通导致并联征询批复意见延缓。在取得产证后根据主管部门对用地地块的设计要求，设计单位重新对施工图进行调整修改，建设规模超过原先体量，项目新增设计两层地下室，整体施工周期增加，并需要主管部门对设计方案及施工组织方案重新进行专家评审，导致项目建设周期拉长，该项目投产时间也将随之顺延。2024 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案》。2023 年 4 月 10 日，公司对相关事项进行了公告，保荐人就此事项出具了明确的核查意见。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况如下：

单位：股

序号	姓名	任职情况	期初持股情况	期末持股情况	报告期内股份增减变动	增减变动原因	质押或冻结情况
1	孙洪军	董事长、总经理、核心技术人员、控股股东、实际控制人	69,585,997	97,448,396	27,862,399	权益分派转增、购入股份	无质押或冻结
2	郭辉	董事、核心技术人员	16,200,000	22,680,000	6,480,000	权益分派转增	无质押或冻结
		副总经理（离任）					
3	程剑涛	核心技术人员	6,214,000	8,269,600	2,055,600	权益分派转增、售出股份	无质押或冻结
		董事（离任）					
4	张忠	核心技术人员	5,140,000	6,847,620	1,707,620	权益分派转增、售出股份	无质押或冻结
5	娄声波	董事、联席总经理	5,086,800	7,121,520	2,034,720	权益分派转增	无质押或冻结
		副总经理（离任）					
6	杜黎明	副总经理、核心技术人员	3,458,700	4,602,180	1,143,480	权益分派转增、售出股份	无质押或冻结
7	杨婷	副总经理（离任） 董事会秘书（离任）	248,400	287,760	39,360	权益分派转增、售出股份	无质押或冻结
8	史艳	财务总监（离任）	0	0	0	不适用	无质押或冻结
9	吴绍夫	监事	528,750	560,250	31,500	权益分派转增、售出股份	无质押或冻结
10	林素芳	监事	0	0	0	不适用	无质押或冻结



序号	姓名	任职情况	期初持股情况	期末持股情况	报告期内股份增减变动	增减变动原因	质押或冻结情况
							冻结
11	管少钧	监事	43,200	60,480	17,280	权益分派转增	无质押或冻结
12	陈小云	财务总监	0	0	0	不适用	无质押或冻结
13	余美伊	董事会秘书	0	0	0	不适用	无质押或冻结

#### 十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司  
2023 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人： 彭捷  
彭捷

王彬  
王彬

  
中信证券股份有限公司  
2024年4月30日